

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-08

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	方正证券策略会、中信建投、申万宏源、东吴证券
时间	2021年5月12日-5月19日
地点	电话会议、策略会举办地（上海）、深圳南山区侨城东路99号深南电路股份有限公司5楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；证券事务代表：谢丹。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、原材料价格上涨对公司毛利率的影响。</p> <p>公司近期部分原材料价格上涨。毛利率系综合性指标，受产品结构、内部运营效率等多方面因素共同作用影响。原材料价格上涨对公司毛利率会存在一定程度影响，公司已采取具体措施进行应对，公司将通过持续开展自动化改造、专业产品线建设、优化设计等方式不断提升生产运营效率，提升工艺水平，节省成本，改善公司毛利率水平；另一方面，公司会加强与供应商、客户的沟通协商，共同面对材料价格上涨压力，努力实现共赢。</p> <p>Q2、目前国内外PCB通信市场整体需求如何。</p> <p>根据工信部信息显示，我国2021年计划新建5G基站60万个。从中长期看，5G通信建设的总趋势不会改变。目前国内通信市场需求以700M项目为主，海外通信市场整体需求同比有所改善。</p>

Q3、公司目前 PCB 业务客户开发重点集中在哪些领域。

公司 PCB 业务将持续深耕通信领域，在现有基础上进一步强化自身优势。同时，公司将加快突破数据中心、汽车电子等市场。目前数据中心领域订单占比提升，客户培育逐渐成熟；汽车电子领域的国内外客户培育进展顺利。

Q4、数据中心市场需求近况。

数据中心是公司看好并重点发展的领域之一，目前订单占比提升。公司募投项目南通数通二期工厂于 2020 年 3 月份连线，爬坡进展顺利，目前产能利用率已接近公司 PCB 业务整体产能利用率的平均水平。

Q5、请介绍公司汽车电子 PCB 业务的发展情况。

公司在汽车电子领域主要聚焦 ADAS 和新能源汽车方向，现有业务主要在深圳工厂进行培育，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，应用在车载雷达、摄像头、新能源等部件中。公司已积极投入汽车电子相关技术研发，与国内外部分知名厂商开展合作，并积极推进南通三期汽车电子专业工厂建设。未来伴随各类终端应用（车联网、物联网）的涌现，汽车也可能成为新型的移动终端，公司在通信领域的技术优势可进一步延伸。

Q6、请介绍公司封装基板业务的发展情况。

公司共拥有深圳 2 家、无锡 1 家封装基板工厂，其中深圳封装基板工厂主要面向 MEMS 微机电系统封装基板、指纹模组、射频模组等封装基板产品，工厂运营成熟，订单延续去年以来的饱满状态；无锡封装基板工厂主要面向存储类封装基板，该工厂自 2019 年 6 月连线生产以来，产能爬坡进展顺利，2020 年 10 月份实现单月盈亏平衡，目前产能利用率已逐步提升，并在毛利层面实现正贡献。

Q7、如何看待封装基板市场国内竞争格局？

全球封装基板市场高度集中，行业在技术、资金及人力资本等方面存在较高的门槛，公司作为国内封装基板领域的先行者以及 02 专项基板项目的主承担单位，已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，在部分细分

	<p>市场上拥有领先的竞争优势。相较于其他内资封装基板厂商，具有相当的技术和先发优势。</p> <p>Q8、公司封装基板业务的产品布局策略。</p> <p>公司封装基板业务将继续保持在 MEMS 等细分市场领先优势，大力开拓存储类封装基板等重要市场，加快 FC-CSP 产品技术突破，推动与国内外关键客户开发与合作。</p> <p>Q9、公司封装基板业务是否有扩产计划。</p> <p>目前封装基板市场需求持续旺盛，公司封装基板业务订单保持在较为饱满的水平，无锡基板工厂产能爬坡顺利，若外部市场保持当前持续旺盛的需求，预计今年可达到满产状态。一方面公司会积极推进无锡基板工厂产能爬坡，并通过技改的方式对现有工厂适时扩充产能，另一方面，公司会进一步优化封装基板产品结构，并加强 FC-CSP 产品技术研究，进行相关技术储备。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 5 月 21 日